



产品选型指南

EEPROM 产品

I²C接口的两线串行 EEPROM

容量	架构	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ^[1]	量产状况 ^[2]	备注 ^[3]
2K	256 x 8	GT24C02	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, PDIP	Production	
4K	512 x 8	GT24C04	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, PDIP	Production	
8K	1K x 8	GT24C08A	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP	Production	
		GT24C08	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, CSP	NRND	
16K	2K x 8	GT24C16	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, PDIP, CSP	Production	
32K	4K x 8	GT24C32A	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, CSP	Production	
		GT24C32	1.8V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP	NRND	
64K	8K x 8	GT24C64	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, CSP	Production	
		GT24C128B	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP	Production	
128K	16K x 8	GT24C128A	1.8V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN	NRND	
		GT24C256A	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP	Production	
256K	32K x 8	GT24C256	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN	NRND	
512K	64K x 8	GT24C512A	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN	Production	
		GT24C512	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP	NRND	
1024K	128K x 8	GT24C1024	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP	Production	

SPI接口的串行 EEPROM

容量	架构	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ^[1]	量产状况 ^[2]	备注 ^[3]
1K	128 x 8	GT25C01	1.8V-5.5V	10	SOIC, TSSOP	Production	
2K	256 x 8	GT25C02	1.8V-5.5V	10	SOIC, TSSOP	Production	
4K	512 x 8	GT25C04	1.8V-5.5V	10	SOIC, TSSOP	Production	
8K	1K x 8	GT25C08	1.7V-5.5V	20	SOIC, TSSOP, UDFN, CSP	Production	
16K	2K x 8	GT25C16	1.7V-5.5V	20	SOIC, TSSOP, UDFN, CSP	Production	
32K	4K x 8	GT25C32A	1.7V-5.5V	20	SOIC, TSSOP, UDFN, CSP	Production	
		GT25C32	1.8V-5.5V	10	SOIC, TSSOP, UDFN	NRND	
64K	8K x 8	GT25C64	1.7V-5.5V	20	SOIC, TSSOP, CSP	Production	
128K	16K x 8	GT25C128A	1.7V-5.5V	20	SOIC, TSSOP, UDFN	Production	
		GT25C128	1.8V-5.5V	10	SOIC, TSSOP	NRND	
256K	32K x 8	GT25C256	1.8V-5.5V	20	SOIC, TSSOP, UDFN	Production	

三线式Microwire总线的串行 EEPROM

容量	架构	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ^[1]	量产状况 ^[2]	备注 ^[3]
1K	128 x 8/64 x 16	GT93C46A	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP, PDIP	Production	
		GT93C46	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP	NRND	
2K	256 x 8/128 x 16	GT93C56A	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP	Production	
		GT93C56	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP	NRND	
4K	512 x 8/256 x 16	GT93C66A	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP, PDIP	Production	
		GT93C66	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP	NRND	
8K	1K x 8/512 x 16	GT93C76	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP	Production	
16K	2K x 8/1K x 16	GT93C86	1.8V-5.5V	3	SOIC, TSSOP	Production	

指定应用的串行 EEPROM

容量	架构	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ^[1]	量产状况 ^[2]	备注 ^[3]
2K	256 x 8	GT34C02A	1.7V-5.5V	1000	SOIC, TSSOP, UDFN	Production	RSWP
		GT34C02	1.7V-3.6V	400	TSSOP, UDFN	NRND	RSWP
2K	256 x 8	GT34TS02	2.7V-3.6V	400	UDFN	Production	RSWP
		GT34TS02A	2.2V-3.6V	400	UDFN	Production	RSWP
4K	256 x 8	GT34TS04	2.2V-3.6V	400	UDFN	Production	RSWP

备注:

1. 对于除所列之外的其他封装需求, 请与销售联系。
2. NRND = 在新的项目和设计中不推荐使用
3. RSWP = 可逆的软件写保护

产品符合工业标准, 工作温度范围 (-40°C to +85°C)

产品手册查询网址: <http://www.giantec-semi.com/products-EEPROM.html>

订货信息: 请参照产品手册





智能卡产品

I²C接口的两线串行 EEPROM

容量	架构	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ⁽¹⁾	量产状况	备注
2K	256 x 8	GT24C02	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	Production	
16K	2K x 8	GT24C16	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	Production	
32K	4K x 8	GT24C32	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	Production	
64K	8K x 8	GT24C64	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	Production	
128K	16K x 8	GT24C128A	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	Production	
		GT24C128	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	NRND	
256K	32K x 8	GT24C256A	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	Production	
		GT24C256	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	NRND	
512K	64K x 8	GT24C512	1.8V-5.5V	1000	wafer, module	Production	

逻辑加密卡芯片

容量	架构	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ⁽¹⁾	量产状况	备注
2K	256 x 8	GT23SC4442	2.7V-5.5V	Up to 5	wafer, module	Production	
8K	1K x 8	GT23SC4428	2.7V-5.5V	Up to 5	wafer, module	Production	
16K	2K x 8	GT23SC1604	2.7V-5.5V	Up to 5	wafer, module	Production	

非接触式CPU卡芯片

编程容量	数据容量	产品型号	电源电压	波特率 (Kbitps)	封装 (8-pin) ⁽¹⁾	量产状况	备注
32K ROM	4K Byte EEPROM	GT23SC4455	N/A	Up to 847	wafer, module	Production	User ROM can be replaced w/EEPROM
32K ROM	8K Byte EEPROM	GT23SC4456	N/A	Up to 847	wafer, module	Production	User ROM can be replaced w/EEPROM
32K ROM	16K Byte EEPROM	GT23SC4458	N/A	Up to 847	wafer, module	Production	User ROM can be replaced w/EEPROM

非接触式逻辑卡芯片

容量	架构	产品型号	电源电压	波特率 (Kbitps)	封装 (8-pin) ⁽¹⁾	量产状况	备注
1K	1K byte EEPROM	GT23SC4439A	N/A	106	wafer, module	Production	ISO/IEC14443A
4K	4K byte EEPROM	GT23SC4469	N/A	106	wafer, module	Production	ISO/IEC14443A

多I/O Flash安全卡芯片 (支持SIM卡的应用)

容量	架构	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ⁽¹⁾	量产状况	备注
160K	160K byte Flash	GT23SC55160	2.7V-5.5V	30	wafer, module	Production	

接触式32K金融社保卡芯片

编程容量	数据容量	产品型号	电源电压	工作频率 (KHz)	封装 (8-pin) ⁽¹⁾	量产状况	备注
80K	32K Byte EEPROM	GT23SC4432	2.7V-5.5V	Up to 5	wafer, module	Production	

注释:

1. 对于除所列之外的其他封装需求, 请与销售联系
2. NRND = 在新的项目和设计中不推荐使用

产品符合工业标准级别, 工作温度范围 (-40°C to +85°C)

产品手册查询网址:<http://www.giantec-semi.com/products-SC.html>

订货信息: 请参照产品手册

